

### Avviso per manifestazione di interesse per

l'affidamento del servizio di interconnessione tramite flip-chip bump bonding del chip di readout e del sensore per l'esperimento PixFEL e per l'upgrade di Fase II del rivelatore a pixel di CMS nell'ambito dell'esperimento RDFASE2

mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

#### **1. OGGETTO DELL'AVVISO**

La Struttura di Pisa dell'INFN intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di interconnessione tramite flip-chip bump bonding del chip di readout e del sensore per l'esperimento PixFEL (Lotto A) e per l'upgrade di Fase II del rivelatore a pixel di CMS nell'ambito dell'esperimento RDFASE2 (Lotto B), come descritto nei rispettivi Capitolati Tecnici dei due lotti.

Atto GE n.11204 del 16/11/2016

Lotto A: Importo presunto: € 31.500 IVA inclusa, CIG: **ZBC1C25EF8**

Lotto B: Importo presunto: € 64.000 IVA esclusa, CIG: **6879624D4F**

#### **2. REQUISITI**

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura, relativamente al solo Lotto A, al solo Lotto B, o ad entrambi i Lotti A e B, tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016
- devono possedere comprovata capacità di eseguire ibridizzazione tramite flip chip bump bonding tra sensore e singolo chip di readout sia per dispositivi disponibili su wafer (RDFASE2 – Lotto B) che di dispositivi in chip singoli (PixFEL – Lotto A), con alta resa e secondo le specifiche indicate nel capitolato tecnico, fornendo indicazioni sui passati contratti di questo tipo completati con successo.

#### **3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d'interesse a essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire le dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestanti la manifestazione d'interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.

ND

Le dichiarazioni, da inoltrare separatamente per i Lotti A e B, sottoscritte dal legale rappresentante e presentate unitamente alla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potranno essere inviate, con oggetto: "*Manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di interconnessione tramite flip-chip bump bonding del chip di readout e del sensore per l'esperimento PixFEL – Lotto A*" e "*Manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di interconnessione tramite flip-chip bump bonding del chip di readout e del sensore per l'upgrade di Fase II del rivelatore a pixel di CMS nell'ambito dell'esperimento RDFASE2 – Lotto B*", mediante PEC al seguente indirizzo PEC: [amministrazione.pi@pec.infn.it](mailto:amministrazione.pi@pec.infn.it)

#### 4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Responsabile del trattamento dei dati: Direttore della Sezione INFN di Pisa.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno contattare:  
dott. Roberto Dell'Orso (tel. +39 050 2214389, mail: [roberto.dellorso@pi.infn.it](mailto:roberto.dellorso@pi.infn.it))

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Roberto Dell'Orso



### Notice for expression of interest for

awarding of the project for Interconnection via flip-chip bump bonding service of the readout chip and sensor for the experiments PixFEL and upgrading Phase II of the CMS pixel detector, by negotiated bid procedure, after consultation, in accordance with art. 36, paragraph 2 of Legislative Decree. N. 50/2016

This notice is intended to receive expressions of interest to promote the involvement and negotiation of the greatest number of Vendors in accordance with the principles of non-discrimination, equal treatment and transparency and does not constitute invitation to participate in the process of being awarded.

#### 1. PURPOSE OF THE NOTICE

The INFN Pisa Structure is planning to entrust, by negotiated procedure after consultation to be awarded to the economically most advantageous tender, the project for interconnection service via flip-chip bump bonding of the readout chip and the sensor for the experiments PixFEL (**Lot A**) and for the upgrade of Phase II of the pixel detector of CMS (**Lot B**), as described in the Technical Specifications documents of the two lots.

Document of GE n.11204 Act of 16.11.2016

**Lot A:** Estimated value: € 31,500 including VAT, IGC: **ZBC1C25EF8**

**Lot B:** Estimated value: € 64,000 excluding VAT, IGC: **6879624D4F**

#### 2. REQUIREMENTS

They may submit expressions of interest to participate in this procedure, relatively to Lot A only, to Lot B only, or to both Lots A and B, all subjects in art. 45 Legislative Decree. N. 50/2016.

Those interested in participating:

- Must not be in the conditions specified in Article 80, paragraphs 1, 2, 4 and 5 of Legislative Decree no. 50/2016;
- Must have the professional expertise requirements of Art. 83, paragraph 3 of Legislative Decree no. 50/2016;
- Must have proven capacity to perform hybridization using flip chip bump bonding between the sensor and single readout chip if parts are available as on-wafer devices (RDFASE2 - **Lot B**) and as single-chip devices (PixFEL - **Lot A**), with high yield and according to the specifications outlined in the technical specifications, providing information on past contracts of this type successfully completed.

#### 3. METHOD AND DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS

Vendors wishing to send their expression of interest to be invited to the negotiated procedure must submit the substitute declaration, drawn up according to Presidential Decree 445/2000, attesting to

29 November 2016

the expression of interest and meet all the eligibility requirements above, completed with personal details, address, phone number, PEC, tax / vat.

The declaration, to be submitted separately for Lot A and Lot B, signed by the legal representative and submitted together with a photocopy of an identity document valid or digitally signed, will be sent, with the subject: "Expression of interest for the concession of the interconnection service via flip -chip bonding of the sensor and readout chip for the experiment PixFEL- Lot A" and "Expression of interest for the concession of the interconnection service via flip -chip bonding of the sensor and readout chip for the upgrading of Phase II of the pixel detector of CMS as part of the experiment RDFASE2- Lot B" by certified e-mail to the following address: PEC amministrazione.pi@pec.infn .it

#### **4. PERSONAL DATA**

The personal data will only be collected and processed for the activities provided by the law and for the institutional purposes of the Institute, according to Legislative Decree. N. 196/2003 and subsequent amendments Responsible for data processing: Director of INFN Pisa.

For further information or clarification please contact:  
dr. Roberto Dell'Orso (tel. +39 050 2214389, email: roberto.dellorso@pi.infn.it)

The Responsible of the Procedure (RUP)  
Roberto Dell'Orso